

电子

周跟踪 (20240708-20240714)

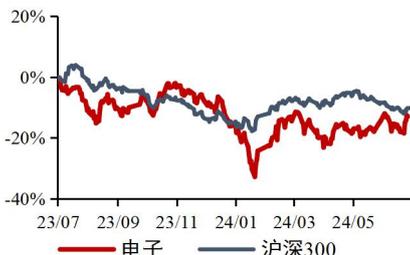
领先大市-A(维持)

台积电上调先进制程报价, AI 驱动半导体行业规模持续提升

2024年7月15日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源: 最闻

相关报告:

【山证电子】AI 供需两旺铸就科技新趋势-2024 年中期策略报告 2024.7.10

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪: Q3 服务器出货动能增强, H2 晶圆厂产能利用率有望提升 2024.7.8

分析师:

高宇洋

执业登记编码: S0760523050002

邮箱: gaoyuyang@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体:** 本周(2024.07.08-2024.07.12)市场整体上涨, 上证指数涨 0.72%, 深圳成指涨 1.82%, 创业板指数涨 1.69%, 科创 50 涨 2.79%, 申万电子指数涨 6.12%, Wind 半导体指数涨 6.18%, 费城半导体指数涨 2.10%, 台湾半导体指数涨 2.71%。细分板块中, 周涨跌幅前三为元件 (+10.04%)、集成电路封测 (+7.81%)、数字芯片设计 (+7.24%)。从个股看, 涨幅前五为: 生益电子 (+44.13%)、朝阳科技 (+31.84%)、博硕科技 (+29.73%)、英飞特 (+26.98%)、富满微 (+26.87%); 跌幅前五为: ST 东旭 B (-19.67%)、ST 旭电 (-18.18%)、百邦科技 (-13.13%)、纳芯微 (-12.07%)、*ST 贤丰 (-9.43%)。

➢ **行业新闻: SEMI 报告: 2024 年全球半导体设备总销售额将达到 1,090 亿美元, 同比增长 3.4%。** 报告指出这将创下新的行业纪录, 同时还预测, 受到前后端细分市场的推动, 半导体制造设备的销售额将在 2025 年继续增长, 达到 1,280 亿美元的新高。**台积电 2025 年晶圆报价或上调 10%。** 由于消费电子、高性能计算对先进处理器的高需求, 台积电计划在 2025 年提高所有类型客户的晶圆价格。与人工智能和高性能计算客户(如英伟达)的谈判表明, 他们可以容忍 4nm 级别晶圆价格大约 10% 的上涨, 大约从每片 18,000 美元上涨到 20,000 美元。这意味着自 2021 年 Q1 以来, N4/N5 晶圆的价格可能至少对某些客户上涨了大约 25%。**半导体销售额预计将在未来十年增长 80%。** AI 技术的迅猛发展正推动半导体行业迈向 1 万亿美元大关, 预计将在 2030 年超过这一里程碑。在各个细分市场中, DRAM 预计将呈现出最强劲的增长势头, 未来十年的收入将翻一番以上, AI 推动平均售价上涨, 从而提高整体收入。

➢ **重要公告: 【深南电路】** 预计 2024 年半年度实现归母净利润 9.10-10.00 亿元, 同比增长 92.01%-111.00%; 实现扣非净利润 8.20-9.10 亿元, 同比增长 92.64%-113.78%。**【生益科技】** 预计 2024 年半年度实现归母净利润 9.00-9.50 亿元, 同比增长 62.00%-71.00%; 实现扣非净利润 8.80-9.30 亿元, 同比增长 70.00%-80.00%。**【风华高科】** 预计 2024 年半年度实现归母净利润 1.85-2.35 亿元, 同比增长 117.47%-176.25%; 实现扣非净利润 1.95-2.45 亿元, 同比增长 142.24%-204.35%。

投资建议

➢ 在 AI 算力、高性能计算驱动下, 先进处理器、高性能存储需求倍增, 拉动先进节点晶圆制造、先进封装价格上涨, 拥有先进技术积累的晶圆制造、封测厂商有望实现业绩高增长。叠加半导体行业周期复苏, 上游材料、设备供应商同步受益。建议关注设备、材料、零部件的国产替代, AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求, 及 AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。





目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
2. 数据跟踪.....	6
3. 新闻公告.....	9
3.1 重大事项.....	9
3.2 行业新闻.....	10
4. 风险提示.....	11

图表目录

图 1： 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2： 周涨跌幅元件、集成电路封测、数字芯片设计表现领先.....	4
图 3： 月涨跌幅元件、消费电子、集成电路封测表现领先（30 日滚动）.....	5
图 4： 年初至今涨跌幅元件、消费电子、集成电路封测表现领先.....	5
图 5： 多数板块当前 P/E 在历史平均值附近.....	5
图 6： 多数板块当前 P/B 低于历史平均值.....	5
图 7： 本周个股涨幅前五.....	6
图 8： 本周个股跌幅前五.....	6
图 9： 全球半导体月度销售额及增速.....	6



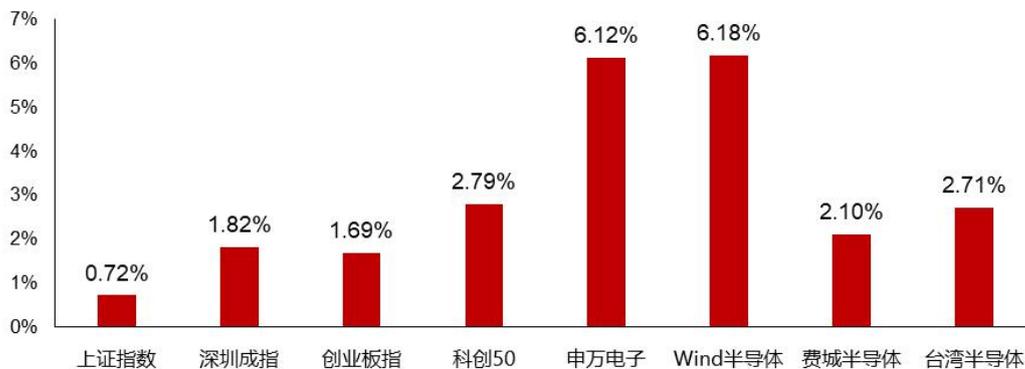
图 10: 分地区半导体销售额.....	6
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	7
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	7
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	7
图 14: 北美半导体设备销售额.....	7
图 15: 日本半导体设备销售额.....	7
图 16: 全球硅片出货面积.....	7
图 17: NAND 现货平均价.....	8
图 18: DRAM 现货均价.....	8
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	8
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	8
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	8
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	9
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	9
表 1: 本周重大事项.....	9
表 2: 本周重要行业新闻.....	10

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.07.08-07.12）市场整体上涨，上证指数涨 0.72%，深圳成指涨 1.82%，创业板指数涨 1.69%，科创 50 涨 2.79%，申万电子指数涨 6.12%，Wind 半导体指数涨 6.18%，费城半导体指数涨 2.10%，台湾半导体指数涨 2.71%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

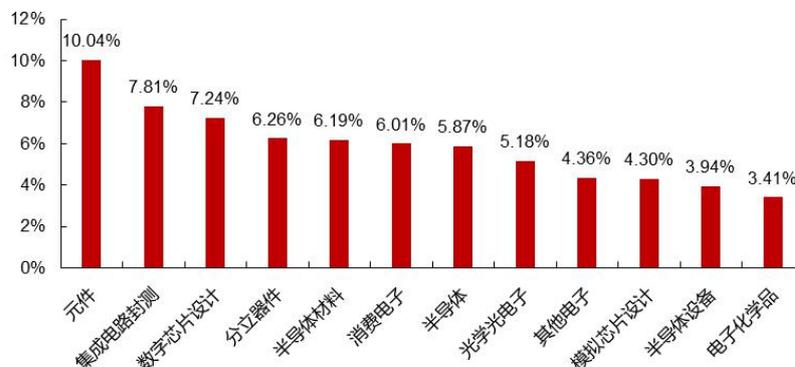


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

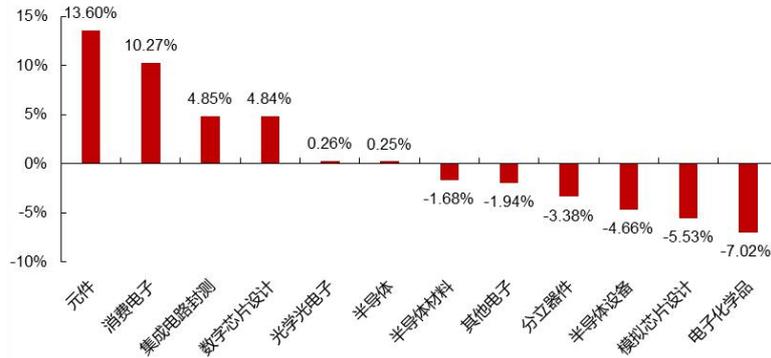
1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅元件、集成电路封测、数字芯片设计表现领先



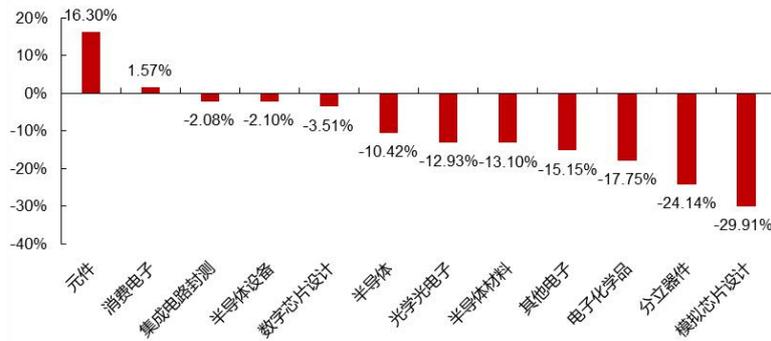
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅元件、消费电子、集成电路封测表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

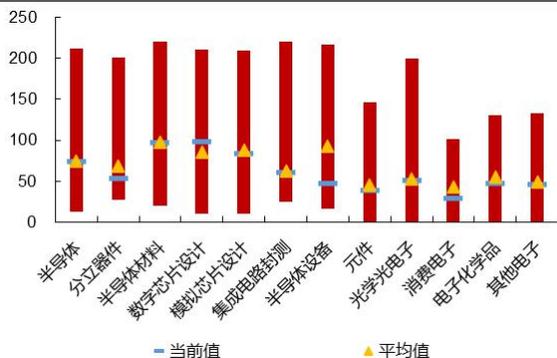
图 4：年初至今涨跌幅元件、消费电子、集成电路封测表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

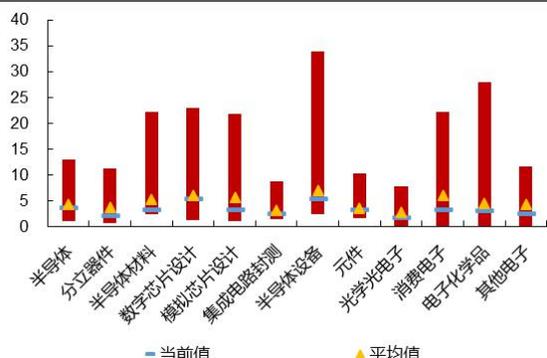
1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E 在历史平均值附近



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 低于历史平均值

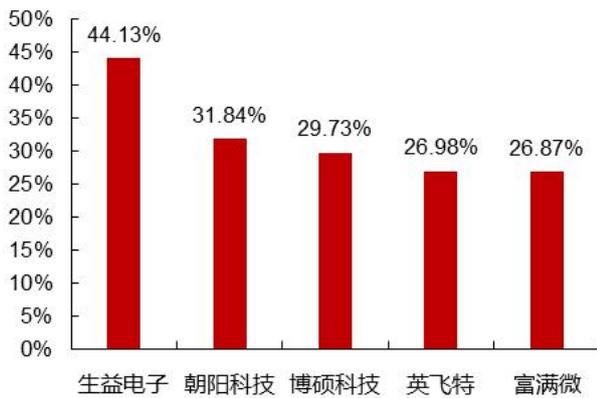


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

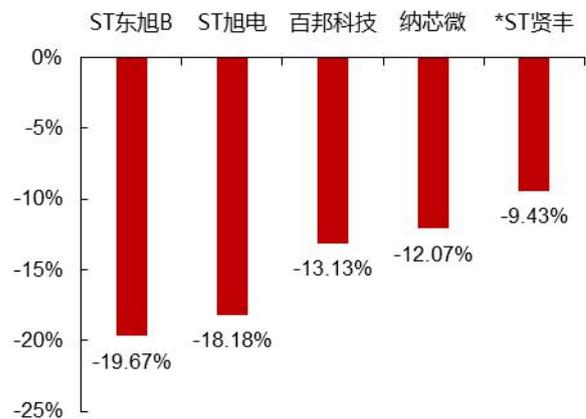
从个股情况看，生益电子、朝阳科技、博硕科技、英飞特、富满微涨幅领先，涨幅分别为+44.13%、+31.84%、+29.73%、+26.98%、+26.87%；ST东旭B、ST旭电、百邦科技、纳芯微、*ST贤丰跌幅居前，跌幅分别为-19.67%、-18.18%、-13.13%、-12.07%、-9.43%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

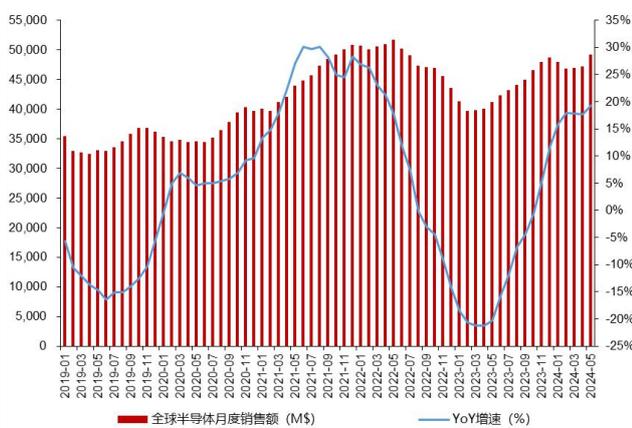
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

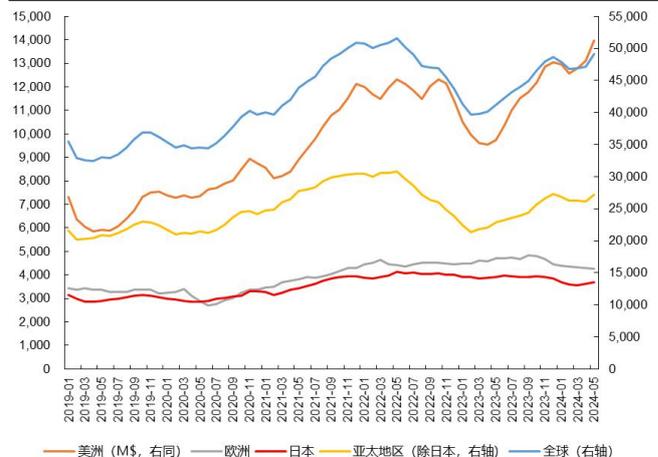
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



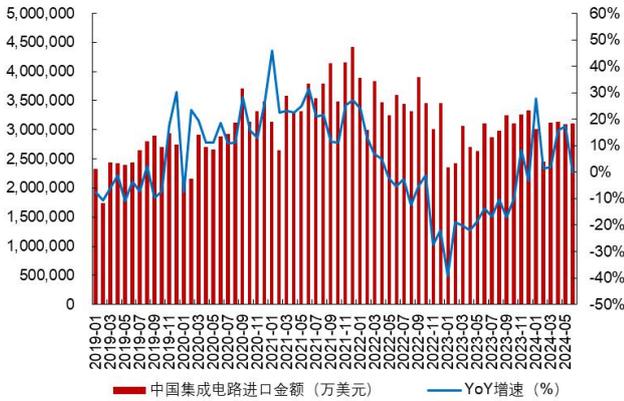
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 10：分地区半导体销售额



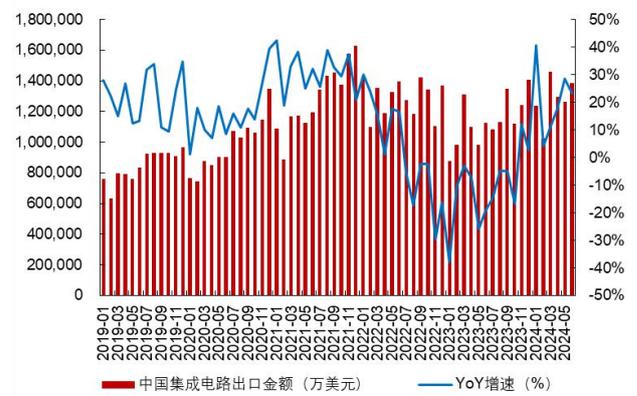
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 11：中国集成电路行业进口情况



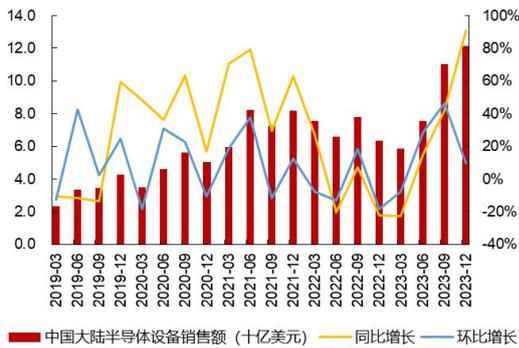
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 12：中国集成电路行业出口情况



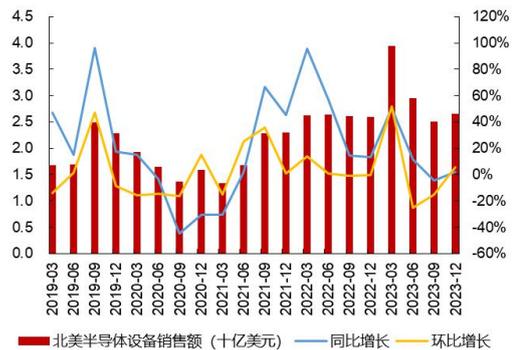
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额



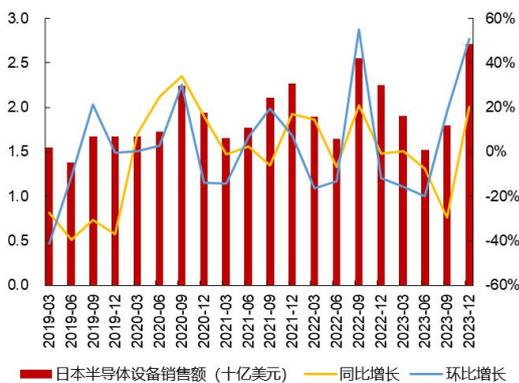
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 14：北美半导体设备销售额



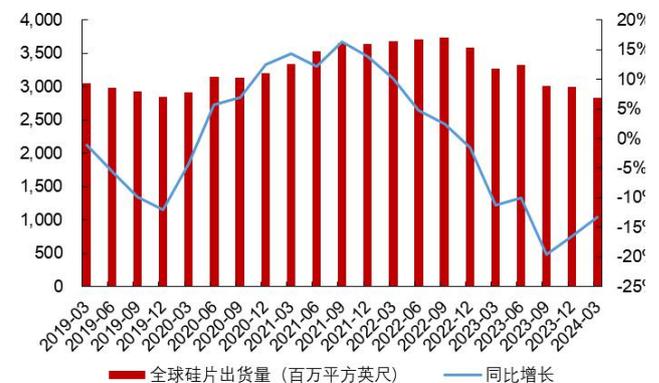
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额



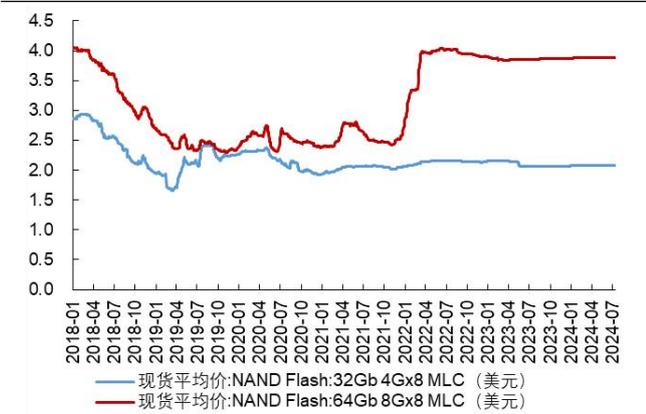
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 16：全球硅片出货面积



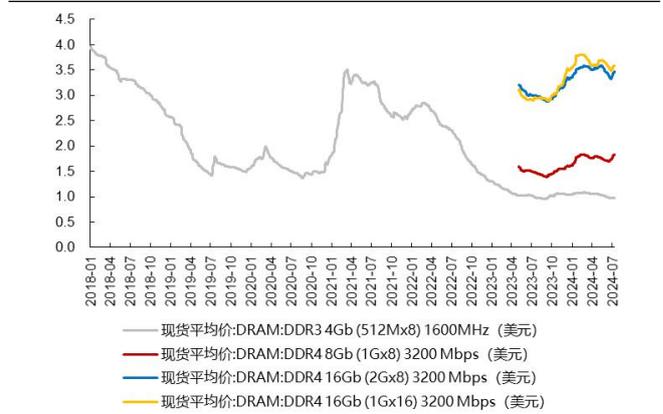
资料来源：SEMI，山西证券研究所

图 17: NAND 现货均价



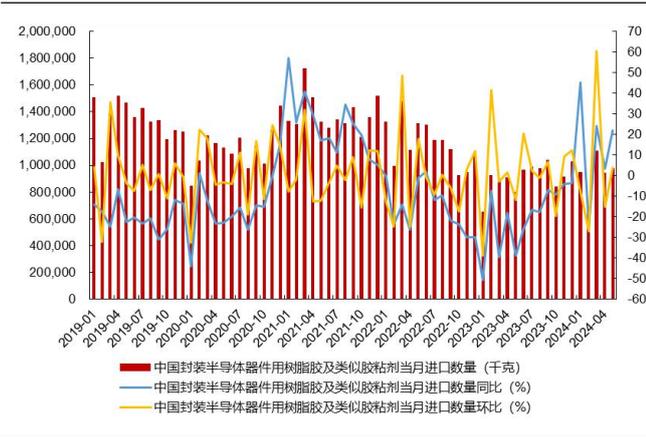
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



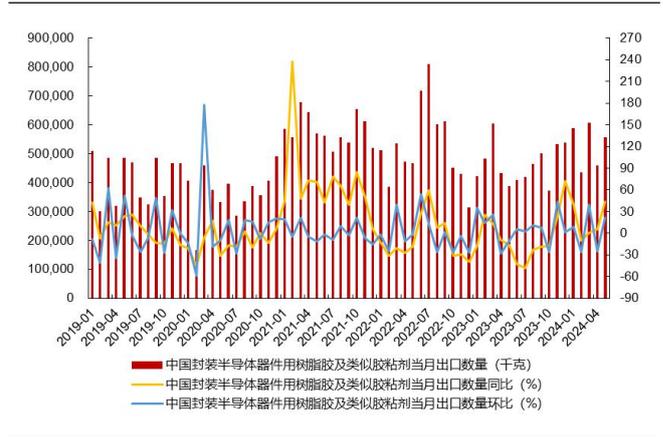
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



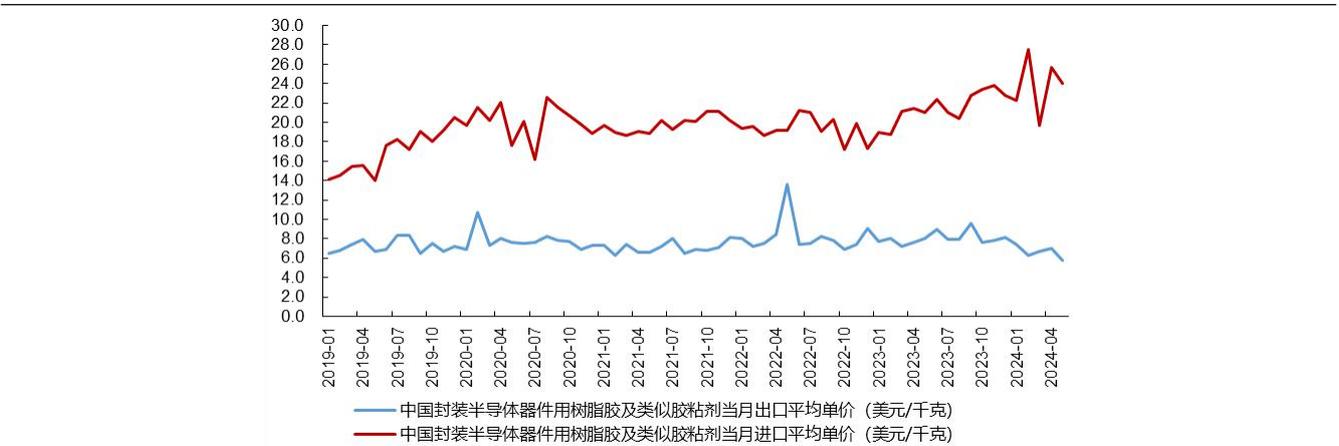
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



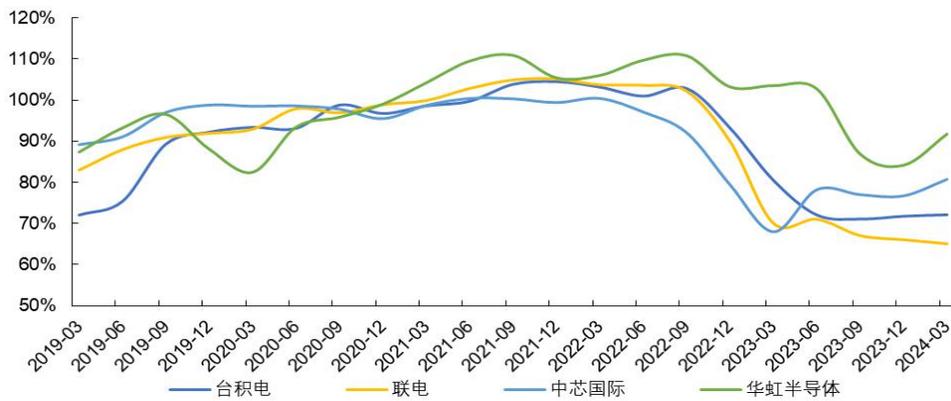
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



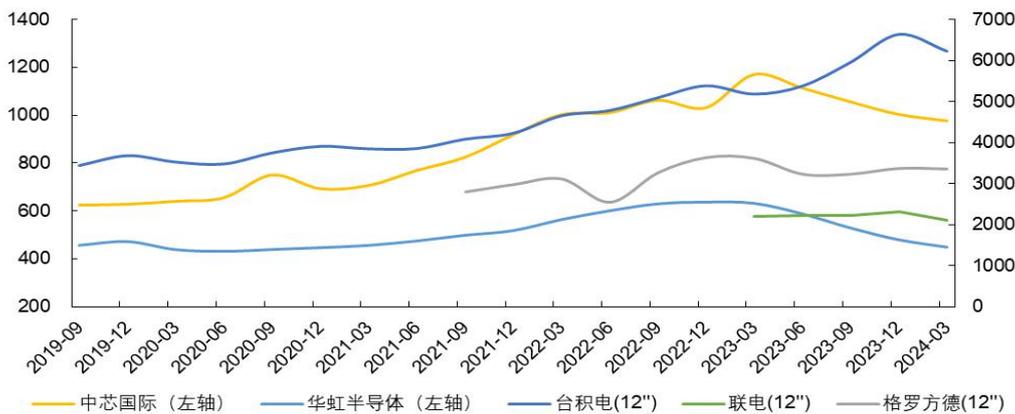
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22: 晶圆厂稼动率 (%)



资料来源: 各公司季报, 山西证券研究所

图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)



资料来源: 各公司季报, 山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1: 本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024 年 7 月 8 日			濮阳惠成		天岳先进
2024 年 7 月 9 日		科翔股份	美芯晟、中熔电气		
2024 年 7 月 10 日		路维光电			

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024年7月11日			中晶科技、东芯股份		
2024年7月12日		力芯微			
2024年7月13日					

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年7月9日	SEMI 报告：2024 年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的 1090 亿美元。 美国加州时间 2024 年 7 月 9 日，SEMI 在 SEMICON West 2024 上发布了《年中总半导体设备预测报告》(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective)。报告指出，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将在 2024 年创下新的行业纪录，达到 1090 亿美元，同比增长 3.4%。报告还预测，半导体制造设备的销售额将在 2025 年继续增长，受到前后端细分市场的推动，2025 年的销售额预计将达到 1280 亿美元的新高。	SEMI
2024年7月10日	台积电 2025 年晶圆报价或上调 10%，CoWoS 或飙升 20%。 由于消费电子和高性能计算对先进处理器的高需求，台积电计划在 2025 年提高所有类型客户的晶圆价格。与人工智能和高性能计算客户，如英伟达 (Nvidia) 的谈判表明，这些客户可以容忍 4 纳米级别晶圆价格大约 10% 的上涨，从大约每片 18,000 美元上涨到大约 20,000 美元。因此，主要由 AMD 和 Nvidia 等公司使用的 4 纳米和 5 纳米节点，预计将看到平均售价 (ASP) 上涨 11%。这意味着自 2021 年第一季度以来，N4/N5 晶圆的价格可能至少对某些客户上涨了大约 25%。此外，摩根士丹利的分析师认为，先进的 CoWoS 封装的价格在未来两年可能会飙升 20%。	爱集微
2024年7月10日	三星电子工会发起“无限期”罢工！存储芯片新一轮“涨价潮”迫近。 全球存储芯片巨头三星电子(Samsung Electronics)2.8 万多名工人组成的工会组织宣布发起“无限期”的罢工行动，在全球存储需求激增之际，此举大举威胁到这家全球最大规模存储芯片制造商的产能。工会呼吁举行最大程度罢工行动，意味着员工们与韩国最大规模企业集团的纠纷急剧升级。三星电子乃全球存储芯片市场份额最高参与者，若无限期罢工无法停止，对全球存储芯片供应将不可避免造成影响，也意味着自今年以来的这波 DRAM 与 NAND 存储芯片涨价浪潮可能停不下来。	智通财经
2024年7月10日	半导体销售额预计将在未来十年增长 80%。 AI 技术的迅猛发展正推动半导体行业迈向 1 万亿美元大关，并预计将在 2030 年超过这一里程碑。此外，到 2034 年，集成电路 (IC) 销售总额预计将达到 1 万亿美元。在集成电路的各个细分市场中，DRAM (动态随机存取存储器) 预计将呈现出最强劲的增长势头，未来十年的收入将翻一番以上。集成电路需求的激增与 AI 的广泛应用密切相关，AI 推动了平均销售价格 (ASP) 的上涨，从而提高了整体收入。	TechInsights
2024年7月10日	AMD 豪掷 6.65 亿美元收购芬兰 AI 初创公司 Silo AI，欲与英伟达争锋。 芯片巨头 AMD 周三宣布，将斥资约 6.65 亿美元现金收购芬兰人工智能初创公司 Silo AI。此	IT 之家

时间	内容	来源
	举旨在增强其人工智能芯片能力，与行业领导者英伟达竞争。大型语言模型的构建和训练即使对于科技巨头来说也是一项挑战。AMD 表示，收购 Silo AI 将帮助其改进 AMD 驱动的人工智能模型的开发和部署，并帮助潜在客户使用 AMD 的芯片构建复杂的人工智能模型。同时，Silo AI 还将加强 AMD 的软件开发能力。	
2024 年 7 月 12 日	HBM4 标准即将定稿 行业有望开启超级景气周期。 行业媒体报道，行业标准制定组织 JEDEC 固态技术协会近日发布新闻稿，表示 HBM4 标准即将定稿，在更高的带宽、更低的功耗、增加裸晶/堆栈性能之外，还进一步提高数据处理速率。2023 年全球 HBM 产值约 43.6 亿美元，2024 年有望翻 4 倍达到 169 亿美元。值得一提的是，全球前三大存储器厂 SK 海力士、三星及美光，正积极投入高频宽存储器（HBM）产能扩充计划，市场人士估计，2025 年新增投片量约 27.6 万片，总产能拉高至 54 万片，同比增 105%。	财联社

资料来源：SEMI，爱集微，智通财经，TechInsights，IT 之家，财联社，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

